

**羅門哈斯公司將於 TPCA 展推出最新的化學鍍鎳鈀浸金製程**

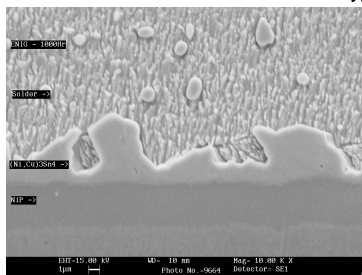
Pallamerse™ SMT 2000 – 結合優良錫焊可靠性及打線接合可靠性的最終表面處理製程

2008 年 9 月 11 日臺灣大園報導 – 羅門哈斯電子材料公司 (Rohm and Haas Electronic Materials, 紐約證券交易所: ROH) 旗下的印刷線路板技術事業部 (CBT, Circuit Board Technologies) 將於本年 10 月 22 至 24 日 TPCA 2008 展 L716 攤位展出, 推出一系列先進的製程及產品, 其中 Pallamerse™ SMT 2000 是最新的最終表面處理製程, 其結合優良錫焊可靠性及打線接合可靠性的特點, 適合應用在要求高連接可靠性的產品上。

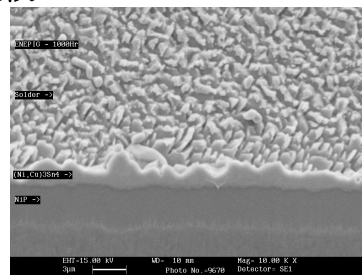
Pallamerse™ SMT 2000 的特性及優點包括: 高於 12 個月的組裝前儲存時間; 能抵擋多次無鉛再流焊循環; 能防止“黑鎳問題”的發生; 化學鍍鈀可作為阻擋層, 不會因銅遷移至金層的問題出現而引起錫銲性錫銲差; 化學鍍鈀層會完全溶解在焊料之中, 在合金介面上不會有高磷層的出現, 當化學鍍鈀溶解後, 會露出一層新的化學鍍鎳層用來生成良好的鎳錫合金, 以提昇高焊點可靠度; 優良的打金線接合能力; 能夠作為按鍵觸碰表面; 所有的成分能夠分析, 可精確的控制槽液。

「電子產品不斷往輕薄短小、多功能、快速運作的方向發展, 因此, 有效提升電子產品內部連接密度及可靠性成為最重要的課題。」CBT 全球技術總監簡浩洋說。Pallamerse™ SMT 2000 優良的錫焊可靠性及打線接合可靠性, 適合應用在 IC 封裝載板的晶片安裝或直接安裝晶片的 HDI 板上。同時, 它可用來代替電鍍鎳金或化學鍍鎳化學鍍金在打線接合方面的應用, 和選擇性化學鍍鎳浸金/有機焊錫保護劑在手機板方面的應用。

**無鉛焊點 (SAC305) 比較**



化學鍍鎳浸金 1000 小時在 155°C 的老化切片圖



化學鍍鎳鈀浸金 1000 小時在 155°C 的老化切片圖

Pallamerse, 羅門哈斯及羅門哈斯電子材料皆為羅門哈斯公司或其關聯公司的商標

### 關於羅門哈斯公司

羅門哈斯（紐約證券交易所：ROH）是為特殊材料行業創造研發創新技術和解決方案的一家全球先鋒企業，自 1909 年以來一直引領業界潮流。該公司的技術在業界得到了廣泛的應用，其中包括：建築與建設、電子與電子設備、家用品與個人防護、包裝與紙張、運輸、藥物與醫療、飲用水、食品及食品相關、以及工業過程。Rohm and Haas 的創新技術和解決方案每天都在全球幫助改善人們的生活。該公司位於美國賓夕法尼亞州費城，2007 年創營收額約 89 億美元。請參閱網頁 [www.rohmhaas.com](http://www.rohmhaas.com) 瞭解更多資訊。

### 關於羅門哈斯電子材料事業群

羅門哈斯電子材料事業群（Rohm and Haas Electronic Materials）為電子和光電子行業開發、提供創新型材料解決方案和製程。其產品和技術側重於電路板、半導體生產、高級封裝和顯示器行業，是世界各地電子產業不可缺少的組成部分。更多資訊，請瀏覽網站 [www.rohmhaas.com](http://www.rohmhaas.com)。

印刷線路板技術事業部的產品包括印刷線路板及太陽能電池製造中金屬化及影像轉移製程所需的化學材料，在臺灣大園、中國東莞、香港、日本新瀉及美國麻塞諸塞州均設有工廠。

### 媒體聯絡人：

羅門哈斯電子材料公司  
謝嘉雯 Elysia Hsieh  
電話：+886-3-574-5472  
電子郵件：[elysiahsieh@rohmhaas.com](mailto:elysiahsieh@rohmhaas.com)